

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

333483

ML6

Erstellt:

Nies, Andreas

Kunde:

AV RT

Datum:

29.01.2024



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1						
A-RAS-PP-1080-470x308-TG150HF-gel-PAN-...	50202535	135		2						
A-RAS-PP-1080-470x308-TG150HF-gel-PAN-...	50202535	0		3						
		35	L2							
A-RAS-ML-0.20-035+035-460x305-TG150HF-...	50202561	200		4					A01	
		35	L3							
A-RAS-PP-2116-470x308-TG150HF-gel-PAN-...	50202536	215		5	P	P				
A-RAS-PP-2116-470x308-TG150HF-gel-PAN-...	50202536	0		6	0	0				B00
		35	L4							
A-RAS-ML-0.20-035+035-460x305-TG150HF-...	50202561	200		7					A02	
		35	L5							
A-RAS-PP-1080-470x308-TG150HF-gel-PAN-...	50202535	135		8						
A-RAS-PP-1080-470x308-TG150HF-gel-PAN-...	50202535	0		9						
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	RS	10						

Dicke nach Verpressen

B00:

1090 µm

Tol+:

120 µm

Tol-:

120 µm

Dmax:

1210 µm

Dmin:

970 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1200 µm

Tol+:

120 µm

Tol-:

120 µm

Dmax:

1320 µm

Dmin:

1080 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1061 µm

Version 1.2.20.19

© Würth Elektronik